

伍、營運概況

一、業務內容

(一)業務範圍

1.所營業務之主要內容

- (1) F219010 電子材料零售業。
- (2) F113070 電信器材批發業。
- (3) F119010 電子材料批發業。
- (4) CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- (5) CC01070 無線通信機械器材製造業。
- (6) CC01080 電子零組件製造業。
- (7) F213060 電信器材零售業。
- (8) ZZ99999 除許可事業外得經營法令未禁止或限制之業務。

2. 所營業務之營業比重

單位：新台幣千元

項 目 \ 年 度	112年度	
	營業收入	比重(%)
高頻整合型元件及模組	1,464,512	98.41%
其他高頻陶瓷元件	23,683	1.59%
合 計	1,488,195	100.00%

3. 公司目前之產品(服務)項目

高頻整合型元件及模組，主要包括：

- (1) 濾波器(Filter)。
- (2) 平衡至非平衡阻抗轉換器(Balun)。
- (3) 平衡阻抗濾波器(Balanced Filter)。
- (4) 雙工器(Diplexer)。
- (5) 三工器(Triplexer)。
- (6) 耦合器(Coupler)。
- (7) 晶片天線(Antenna)。
- (8) 晶片天線模組(Antenna Module)。
- (9) 藍芽模組(Bluetooth Module)。
- (10) 射頻前端模組(Front-end Module)。
- (11) 天線開關模組(Antenna Switch Module)。
- (12) 高頻晶片陶瓷元件，主要包括電感及電容等被動元件。

(二)產業概況

1.產業現況與發展

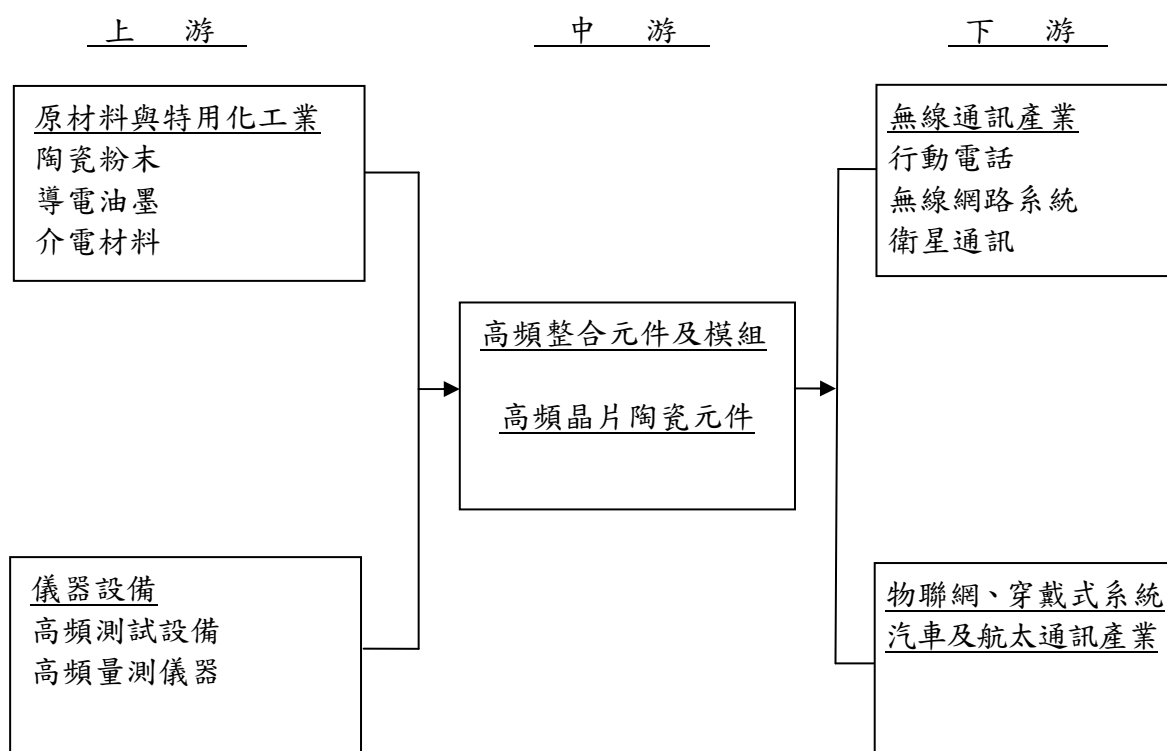
隨著行動通訊技術的快速發展，相關終端產品及通訊設備的成長進一步帶動無線通訊的需求。無線通訊的終端應用範圍很廣，如智慧型手機、無線區域網路(WLAN)、藍芽(Bluetooth)、全球定位系統(GPS)、筆記型電腦、平板電腦、無線電話、無線對講機、呼叫器、家庭無線(Home RF)、數位廣播、無線數據機、無線傳真機、車用電子、遊戲機，以及新興的物聯網與穿戴裝置應用等等。由於全球市場對無線通訊應用需求急速增加，使無線通訊的頻段大幅躍升，且由於無線可攜式產品小型化、多元功能及高傳輸速度的趨勢下，此即引發市場對高頻整合元件及模組的高度需求。

雖然系統愈趨複雜，但各種通訊系統實際所用的內部零組件數目卻日益整合，這主要歸因於線路的積體化，至於被動元件的積體化，目標乃朝向系統級封裝(System in a Package：SiP)或系統單晶片(System on a Chip：SoC)發展。由於終端產品內建各項無線通訊應用已是未來發展主流，模組化也必將成為通訊元件未來發展的趨勢，而高效能的元件模組化需要利用高密度的構裝製程，以通訊市場的供應鏈來看，擁有SiP高密度系統構裝技術的廠商，可提供上、下游整合性服務，未來將成為晶片設計及終端產品公司積極尋求的合作夥伴。

以無線通訊應用中的智慧型手機、GPS、WLAN及Bluetooth為例，其功能、特性或市場雖有不同，但相同的是對所需零組件之高密度電路、小型化、高頻化、積體化及模組化的高度需求。本公司所經營之高頻整合元件及模組與高頻晶片陶瓷元件乃應用於無線通訊市場，為國內第一家且最具規模專注於射頻(RF)整合元件與模組的設計及製造公司，因著所開發的產品符合市場期待且整合型的終端應用具高度成長動力下，本公司為國內RF通訊關鍵零組件產業中最具高度成長與發展潛力的公司。

2. 產業上、中、下游之關聯性

高頻整合元件及模組與高頻晶片陶瓷元件在上游原材料產業方面，主要包括陶瓷粉末、導電油墨及介電材料，主要製程儀器設備包括雷射打孔機、端銀機、連續爐、打線機、外檢機、射頻測試機及網路分析儀等。下游產業包括無線通訊產業、車用電子系統及航太通訊產業等，其與上中下游產業供需息息相關，茲將其上、中、下游產業關聯圖列示如下：



3.產品之發展趨勢及競爭情形

無線通訊產品多功能化及小型化已成為市場趨勢，順應無線通訊元件的發展將朝向高頻化、小型化及模組化的方向發展。

近年來我國無線通訊蓬勃發展，無論是在智慧型手機、無線區域網路(WLAN)、全球定位系統(GPS)、藍芽(Bluetooth)、物聯網與穿戴裝置等主流應用都呈現高度成長，然而相對於國際大廠，我國在無線通訊高頻元件及模組化技術的發展卻仍屬薄弱。目前全球整合元件大廠以日、美、歐為首，如日本的Murata、Kyocera、TDK；美國的CTS及歐洲的Bosch、CMAC等大廠，反觀國內廠商，由於起步較晚，目前我國在全球市佔率中相對產值仍低。

有鑑於無線通訊的應用將是未來市場成長的核心，本公司積極開發具有前瞻性及創新的高頻元件及模組化尖端技術，以期掌握未來無線通訊成長的契機。

(三)技術及研發概況

1.112年度投入研發費用為新台幣94,514千元。

2.最近年度研發計畫、未完成研發計畫之目前進度、須再投入研發費用、預計完成量產時間及未來影響研發成功之主要因素：

(1)研究發展

由於本公司研發團隊同時在RF通訊及材料工程領域具備深厚的學術基礎及產品開發經驗，不論在技術發展及商業應用上均能掌握市場脈動。研究發展上則以有效提升RF元件整合度及模組化技術為二大重點方向，主要研發項目大致可分為技術分析、新產品開發、製程改善、材料配方及品質分析等構面。

(2)最近年度開發成功之技術或產品

年度	開發成功之技術或產品
112年	1. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WiFi-7雙頻通訊系統使用之低損耗雙工器。 2. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，2.5GHz通訊系統使用之低溫漂1:2平衡至非平衡阻抗轉換濾波器。 3. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WiFi-7雙頻通訊系統使用之側邊端電極封裝雙工器。 4. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WiFi-7雙頻通訊系統使用之高抑制雙工器。 5. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，中國市場5G通訊系統使用之高隔離度雙工器。 6. 開發完成尺寸3.2mmx2.5mm，WiFi 6E通訊系統使用之高抑制帶通濾波器。 7. 開發完成尺寸3.2mmx2.5mm，WiFi 6E通訊系統使用之低損耗高抑制帶通濾波器。 8. 開發完成尺寸1.0mmx0.5mm，WiFi 6E通訊系統使用之小型化薄型耦合器。 9. 開發完成尺寸1.1mmx0.9mm，WiFi 2.4G通訊系統使用之小型化帶通濾波器。 10. 開發完成尺寸4.5mmx3.2mm，WiFi 路由器通訊系統使用之5.5GHz高抑制隔離且未犧牲鄰近通道的帶通濾波器。 11. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，BT/WiFi通訊系統使用之整合型發射/接收濾波器。 12. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WiFi-7雙頻通訊系統使用之底部端電極封裝雙工器。 13. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，消費性電子產品使用之抑制電磁干擾濾波器。 14. 開發完成尺寸5.5mmx3.2mm，WiFi 5G通訊系統使用之雙邊頻段多階高抑制隔離帶通濾波器。 15. 開發完成尺寸3.2mmx2.5mm，1.8GHz通訊系統使用之75歐姆低溫漂低通濾波器。 16. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，超寬頻通訊系統使用之高抑制帶通濾波器。 17. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，WiFi 6E通訊系統使用之3dB耦合器。 18. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，WiFi 雙頻通訊系統使用之平衡式複數阻抗接收雙工器。 19. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，WiFi 雙頻通訊系統使用之整合型複數阻抗平衡至非平衡阻抗轉換發射濾波器。 20. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，5G N77通訊系統使用之低損耗高抑制帶通濾波器。

年度	開發成功之技術或產品
	21. 開發完成尺寸1.0mmx0.5mm，5G N77通訊系統使用之低損耗高抑制帶通濾波器。 22. 開發完成尺寸1.0mmx0.5mm，5G N77通訊系統使用之小型薄型化高抑制帶通濾波器。 23. 開發完成尺寸0.6mmx0.5mm，5G N77通訊系統使用之微小型低損耗帶通濾波器。 24. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，5G N77通訊系統使用之低損耗帶通濾波器。 25. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，5G N77通訊系統使用之高抑制帶通濾波器。 26. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，全球衛星導航系統使用之低溫漂雙工器。 27. 開發完成尺寸2.5mmx2.0mm，5G行動通訊系統使用之高隔離度三工器。 28. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WiFi/BLE通訊系統使用之高抑制帶通濾波器。 29. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，WiFi 5G雙頻雙發無線系統使用之雙工器。 30. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，WiFi 6G雙頻雙發無線系統使用之雙工器。 31. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WiFi 6E通訊系統使用之低價低損耗雙工器。 32. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，WiFi 6E通訊系統使用之低損耗帶通濾波器。 33. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，Sub-GHz無線系統使用之可電鍍封裝複數阻抗平衡至非平衡阻抗轉換濾波器。 34. 開發完成尺寸2.0mmx1.25mm，LTE通訊系統使用之低損耗雙工器。 35. 開發完成尺寸1.6mmx0.8mm，5G N79通訊系統使用之低損耗高抑制帶通濾波器。 36. 開發完成尺寸5.5mmx3.2mm，WiFi 6E通訊系統使用之5.5GHz低價高抑制隔離帶通濾波器。 37. 開發完成尺寸1.0mmx0.5mm，5G N79通訊系統使用之低損耗高抑制帶通濾波器。

(3)未完成研發計畫之目前進度、須再投入研發費用及預計完成量產時間

112年未完成之研發計畫	目前進度	預計完成量產時間	須再投入研發費用(千元)
開發縮小化整合型元件	85%	113年/Q3-Q4	25,000
開發縮小化多頻、多模整合型模組	85%	113年/Q1-Q2	25,000
高精密度材料、製程開發	75%	113年/Q3-Q4	30,000

(4)未來影響研發成功之主要因素

- ①正確的研發策略並有效掌握產品開發時程，以達到產品 time to market。
- ②良好的產品設計能力，及早有效 Design-in 客戶端之產品設計。
- ③優秀穩定的研發團隊，使研發經驗可有效累積並推升產品開發能力。

(5)未來研發計畫及預計投入之研發費用

未來研發計畫	未來三年預計投入研發費用(千元)
開發縮小化整合型元件	100,000
開發縮小化多頻/多模整合型模組	90,000
高精密度材料/製程開發	110,000
總計	300,000

(四)長短期業務發展計畫

1.短期發展計畫

- (1)模組化開拓主力產品。
- (2)產品小型化及多功能化。
- (3)強化中國及新興市場的開發。

2.長期發展計畫

- (1)模組化開拓新興產品。
- (2)系統級封裝技術的開發。
- (3)策略聯盟的合作模式。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 主要產品(服務)之銷售地區

單位：新台幣千元

銷售區域 \ 年度		111年度		112年度	
		金額	%	金額	%
內銷		297,032	20.27	331,361	22.27
外銷	美 洲	398,429	27.19	341,012	22.91
	亞 洲	756,225	51.61	803,864	54.02
	歐 洲	13,596	0.93	11,958	0.80
	小 計	1,168,250	79.73	1,156,834	77.73
合計		1,465,282	100.00	1,488,195	100.00

2. 市場占有率

近年來由於無線通訊市場蓬勃發展，帶動了低溫陶瓷(LTCC)元組件產業呈現大幅成長，根據Research Allied估計，2020年LTCC全球年產值約32.2億美元，到2027年將達到75.9億美元；供應鏈中以日本為最大的供應國，市場佔有率高達50%，主導了全球LTCC產品市場及技術，其次為美國與歐洲，而國內廠商由於起步較晚，相對市場佔有率仍低。

本公司所生產的高頻整合型元件、模組及高頻晶片陶瓷元件，主要包括濾波器、平衡至非平衡阻抗轉換器、平衡阻抗濾波器、雙工器、三工器、耦合器、晶片天線、晶片天線模組、藍芽模組、射頻前端模組、天線開關模組、電感及電容等被動元件，普遍應用在智慧型手機、無線區域網路、藍芽、GPS、物聯網與穿戴裝置等終端設備。由於本公司為國內早期投入且專營RF整合元件與模組的公司，當產品進入市場後，以優良的品質、具競爭力的價格與高時效的服務，在很短時間內即獲得國內外客戶的肯定，目前在技術層次及市場佔有率上均居國內領導地位，全球市佔有率約2%。

3. 市場未來之供需狀況與成長性

隨著全球電信自由化及通訊技術的精進，無線通訊已成為3C產業中最具成長動能的產業，展望未來，當終端產品都走向整合的趨勢下，手機的普及率及可攜式具有絕佳的競爭優勢以整合其他產品功能，其中智慧型手機即是典型的代表。智慧型手機在具備愈來愈強的運算及多媒體功能後，衍生出上網、下載及分享等功能，此即需要有更多元的傳輸管道、更高的傳輸頻寬及更優質的傳輸效率，因此也引發手機目前及未來將結合的各種通訊功能，從區域的WLAN，短距的Bluetooth及ZigBee，到長距的WiMAX，再加上GPS與行動電視功能，將語音、數據與視訊等多功能結合，打造了全方位的通訊平台。MIC預估，2024年智慧型手機全球出貨量將達11.5億支，其中5G智慧型手機滲透率為68%；個人穿戴裝置全球出貨量將達5.23億台，預估2027年出貨量達6.45億，年複合成長率5.4%；GPS因車用導航定位服務在全球各地的擴展，也將是未來幾年具高成長潛力的產品；至於新興的物聯網應用，如智慧家庭、智慧製造、智慧健康及智慧交通等智慧應用的快速發展，預期未來物聯網所帶來的經濟效益將十分可觀。

本公司所經營的RF整合元件及模組為無線通訊產品必需使用的關鍵零組件，智慧型手機、電腦、無線網路、全球衛星定位系統、物聯網及穿戴裝置等通訊產品直接牽動LTCC未來市場的發展。由於現行主流的無線通訊應用在未來幾年仍呈現高度成長以及未來新興通訊產品也朝向多功能整合發展的趨勢下，市場對本公司所生產的整合元件及模組產品將會有更高的需求。

4. 競爭利基

(1) 兼具四大核心技術

本公司擁有產業中極少能夠同時具備之先進 RF 電路設計、材料開發、製程設計及產品測試等四大核心技術，由於自主掌控 RF 及材料二大領域的關鍵技術，有能力提供高效率的客製化產品及服務。

(2) 產品定位符合市場發展主流

無線通訊為近年來最具成長動力的產業，隨著終端產品的大幅成長，將直接帶動對本公司產品的需求。此外，由於行動通訊多元功能及微型化的趨勢，本公司以 SiP 及 LTCC 製程所開發之高頻整合元件及模組正符合市場期待，將更進一步推升市場需求，使本公司成長前景看好。

(3) 優質產品服務

結合研發及製程優勢，本公司可提供相較於國際同業更具時效性、高客製化、彈性並具成本競爭優勢的全方位服務，以贏得客戶的高度信賴和認同。

5. 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

(1) 有利因素

- ① 產業高度成長
- ② 技術領先國內同業
- ③ 國內居首並進軍國際
- ④ 高競爭力全方位服務
- ⑤ 兼顧品牌及代工模式

(2) 不利因素與因應對策

- ① 無線通訊產品推陳出新，產品週期短且價格下滑快，擠壓獲利空間。

因應對策：

- A. 縮短新產品開發時程，致力於高階產品，避開價格戰的成熟型產品。
- B. 以設計導入(Design-in)，於客戶產品設計階段即參與產品開發。
- C. 以多元化產品，分散單一產品價格競爭之風險。
- D. 強化製程改善，提升良率與設備稼動並降低能源耗用。

- ② 研發人才缺乏

因應對策：

- A. 積極參與國內工業局主導性新產品計畫並爭取國外技術移轉或共同開發機會，以刺激研究發展與技術升級。
- B. 建立研發知識管理資料庫，使研發經驗與成果有效傳承，發揮最高研發人力效益。

(二) 主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途

產 品 種 類	重 要 用 途
高頻整合元件及模組 高頻晶片陶瓷元件	行動衛星電話 (MSS)、蜂巢式行動電話 (Cellular Phone)、無線電話 (Cordless Phone)、無線區域網路 (WLAN)、全球定位系統 (GPS)、藍芽 (Bluetooth)、超寬頻 (UWB)、全球微波存取互通 (WiMAX)、ZigBee、多重輸入輸出 (MIMO)、Wi-Fi、功率放大器 (PA)、衛星降頻器 (LNB)、家用無線收發器 (Home RF)、物聯網 (IoT)、遊戲機及穿戴式裝置等。

2. 產製過程

原料→漿料配置→刮刀成型→沖孔→填孔→網印→疊壓→切割→燒結→上端電極→燒附→電鍍→電性測試→包裝→出貨

(三)主要原料之供應狀況

主要原料名稱	主要供應商	供應狀況
陶瓷粉末	杜邦、台灣賀利氏	良好
導電油墨	杜邦、台灣賀利氏、台灣雙日、大洲	良好

(四)最近二年度進銷貨總額百分之十以上之客戶名單

1. 最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名單

單位：新台幣千元

項次	111年度				112年度			
	名稱	金額	比率(%)	與本公係 司關係	名稱	金額	比率(%)	與本公係 司關係
1	A	36,522	19.21	無	C	46,114	18.51	無
2	B	22,268	11.71	無	A	45,409	18.23	無
3	C	22,176	11.67	無	D	33,576	13.48	無
4	D	18,902	9.94	無	B(註1)	4,875	1.96	無
5	其他	90,219	47.47		其他	119,121	47.82	
進貨淨額		190,087	100.00		進貨淨額	249,095	100.00	

註1：B供應商進料尚有存庫，故112年度進貨次數較少。

2. 最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名單

單位：新台幣千元

項次	111年度				112年度			
	名稱	金額	比率(%)	與本公係 司關係	名稱	金額	比率(%)	與本公係 司關係
1	a	218,350	14.90	註1	a	253,732	17.05	註1
2	b	176,433	12.04	無	b	190,436	12.80	無
3	c	169,970	11.60	註1	d	185,453	12.46	無
4	d	91,964	6.28	無	c	79,900	5.37	註1
5	其他	808,565	55.18		其他	778,674	52.32	
銷貨淨額		1,465,282	100.00		銷貨淨額	1,488,195	100.00	

註1：該公司為本公司法人董事。

(五)最近二年度生產量值表

單位：新台幣千元

生產量值 主要商品	年 度	111年度			112年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
高頻整合元件及模組 高頻晶片陶瓷元件		註1	註 1	925,948	註1	註 1	867,147

註1：本公司產品結構不盡相同，故不列示產能及產量。

(六)最近二年度銷售量值表

單位：百萬顆；新台幣千元

銷售量值 主要商品	年 度	111年度				112年度			
		內 銷		外 銷		內 銷		外 銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
高頻整合元件及模組 高頻晶片陶瓷元件		390	297,032	1,187	1,168,250	426	331,361	1,130	1,156,834

三、從業員工

年 度		111 年度	112 年度	截至 113 年 4 月 16 日
員 工 人 數	直接人員	158	162	167
	間接人員	49	43	41
	管銷人員	38	37	36
	研發人員	40	40	40
	合計	285	282	284
平 均 年 歲		39.0	39.0	39.2
平 均 服 務 年 資		8.8	9.0	9.1
學 歷 分 布 比 率	博士	3.2%	3.2%	3.2%
	碩士	15.7%	14.9%	14.4%
	大專	45.6%	48.2%	49.3%
	高中	26.3%	24.8%	24.6%
	高中以下	9.2%	8.9%	8.5%

四、環保支出資訊

(一)最近年度及截至年報刊印日止，本公司因污染環境所遭受之損失：

處分日期及字號	112年10月25日 環業字第1123402567號
違反法規條文	廢棄物清理法第36條第1項及事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準第7條第2項
違反法規內容	有害事業廢棄物貯存逾一年
處分內容	裁處新台幣6萬元及接受環境講習2小時

(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：貯存逾一年之有害廢棄物已完成清除。

五、勞資關係

(一)公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議情形：

1. 員工福利措施

- (1)員工酬勞：於公司章程第25條規定，當年度如有獲利則提撥不低於5%水準，並考量整體經營結構及產業分配情況提列員工酬勞。
- (2)獎金制度：除員工酬勞外，依公司ESG達成情況及員工績效提供具高度競爭力獎金制度，包括三節獎金、績效獎金、營運獎金…等，以激勵士氣並留任優秀員工。
- (3)年度調薪制度：依公司獲利狀況、整體經濟環境、同業間水平及員工個人貢獻度與績效評核結果進行整體調薪。
- (4)免費健康檢查：員工定期實施健康檢查，並依檢查結果進行分級健康管理，實施追蹤複檢及健康衛教。
- (5)完善的保險計畫：員工自到職日起，即享有勞工保險、全民健康保險及團體保險。
- (6)貼心工作環境：本公司設有免費室內停車位、員工休息室、哺乳室及員工餐廳等設施，並提供員工團膳餐費補助。
- (7)福委會福利項目：各項旅遊活動、聯歡餐會、抽獎及各類活動；年節、生日禮金、婚喪喜慶等各項福利補助。

2. 員工進修及訓練情形

本公司依「員工教育訓練管理程序」，按員工專業職能及學習需要規畫相關培訓課程。

(1)訓練體系

- ①工作指導式訓練：單位主管對部屬的平日工作指導或工作職掌內的訓練。
- ②集中式訓練：考量人力資源發展，組織目標及員工教育訓練需求，提出年度教育訓練計畫。
 - A. 新進人員訓練：新進人員應接受職前訓練。
 - B. 職能別訓練：加強本職專業技能。
 - C. 通識課程：企業永續發展、資訊安全、職業安全與衛生及自我啟發等課程。
- ③管理才能訓練：基層主管、中階主管、高階主管所排定訓練課程。

(2)本年度教育訓練執行情形

本年度公司舉辦的內部及外部教育總訓練時數為2,711小時，平均每位員工的訓練時數約9.6小時；總訓練費用為新台幣17仟元。

3. 員工退休制度

- (1)本公司依據勞動基準法之規定訂定員工退休辦法，組成勞工退休準備金監督委員會，依每月薪資總額提撥2%之勞工退休準備金儲存於勞工退休基金專戶中，做為未來支付勞工退休準備金之用。本公司並依國際會計準則第十九號員工福利中確定給付退休辦法依合格精算師出具之退休金精算報告，於帳上提列退休金、承認退休金負債。
- (2)本公司於自94年7月1日起，本公司依據勞工退休金條例，訂有確定提撥之退休辦法，並就員工選擇適用勞工退休金條例部分，每月按不低於薪資之6%提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。

4. 勞資間之協議情形

本公司是一個開放式的管理環境，管理階層與員工間隨時有各種形式的討論與溝通，任何問題都可以即時以互動溝通方式達到一致的共識，並關心同仁間的互動與溝通，讓員工和公司之間能夠透過彼此的溝通與了解，達到共同成長與茁壯的目的，本公司建構一個具有挑戰性且富有學習機會的工作環境，勞資之間關係和諧，因此並未發生勞資糾紛。

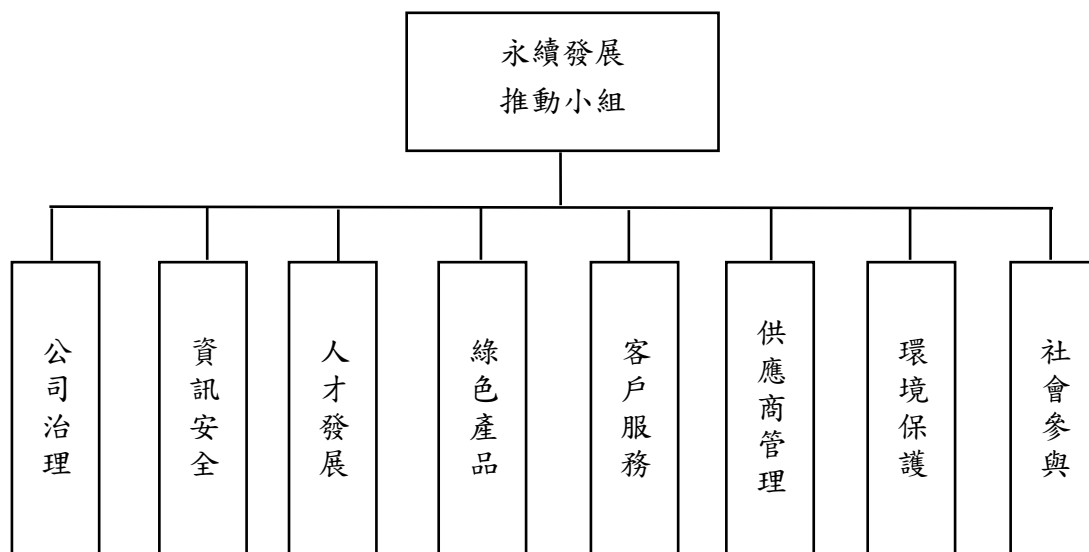
5. 各項員工權益維護措施情形：依勞動基準法規定辦理。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，應列明處分日期、處分字號、違反法規條文、違反法規內容、處分內容)，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

六、資通安全管理：

(一)敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源等。

1. 資通安全風險管理架構



本公司成立永續發展團隊，負責推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等政策或制度之提出及執行。團隊主席由總經理擔任，底下設置公司治理、資訊安全、人才發展、綠色產品、客戶服務、供應商管理、環境保護及社會參與之推動小組，負責訂定永續發展政策、目標及推動相關活動。推動小組主要由各部門主管擔任，並由相關業務部門組成。永續發展團隊依循PDCA循環運作，每年年底檢討運作之成效，並向董事會報告。資訊安全專責小組，負責資安政策之建立、資安規章制定、資訊設備評估、檢查及更新、教育訓練、資通安全監控及事故調查，以建構完善資安防護能力及培訓同仁正確資訊安全意識。

2. 資通安全政策：『重視營業祕密、個人隱私及資通安全』

3. 具體管理方案

人員管理及資安教育訓練	◆ 對資訊相關職務及工作，審慎評估人員之適任性。 ◆ 負責重要資訊系統之管理、維護、設計及操作之人員，妥適分工並建立制衡機制。 ◆ 定期辦理資訊安全教育訓練及宣導。
電腦系統安全管理	◆ 私人電腦或平板禁止使用。 ◆ 建置防毒保護措施並定期更新，以確保系統正常運作。 ◆ 禁止安裝非公務使用及未合法授權之軟體。 ◆ 個人電腦的使用權限嚴格控管，防止不當使用電腦。
系統存取控制	◆ 資料庫及檔案存取，設立使用權限及責任。 ◆ 離職人員立即取消所有權限；人員調動立即調整權限。 ◆ 密碼長度、複雜度及定期更換頻率設有規範。 ◆ 個人USB禁止使用。
系統開發及維護安全管理	◆ 自行或委外開發系統，在系統生命週期之初始階段，即將資通安全需求納入考量。 ◆ 資訊工作委外處理時，與廠商簽定資安及保密條款。 ◆ 委託廠商建置及維護設施時，本公司人員將全程陪同。
永續運作規畫及管理	◆ 每日進行資料備份，並建制異地備援機制。 ◆ 每半年進行系統復原計畫之測試及演練，並檢討相關測試缺失。 ◆ 每年內部稽核執行資安作業稽核並將結果報告董事會。

4. 投入資通安全管理之資源

- (1)所有新進員工皆完成資安訓練課程。
- (2)勒索變種病毒預防宣導142人次。
- (3)委託外部專家執行網路與資訊安全評估4次。
- (4)購置居家辦公資安軟體(1年期)。
- (5)成為台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT)會員。

(二)列明最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實：無

七、重要契約：無